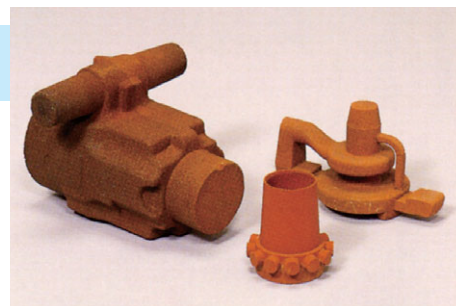


13

鋳物用

シェルモールド用、常温自硬化性用に特徴のある樹脂を用意しております。



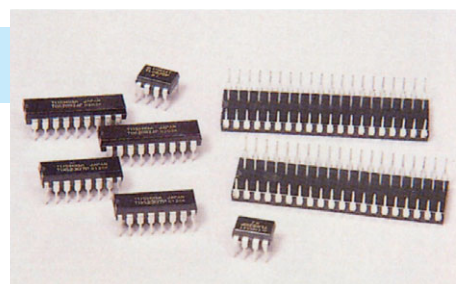
| 品名 | 用途・特長 | 樹脂の特性 | |
|---------|---------------------|--------------|---------|
| | | プレート・70-(mm) | 融点(°C) |
| BRP-510 | 塗型用 分散性良好 ノボラック・ヘキサ | 15 — 35 | 80 — 90 |

| 品名 | 用途・特長 | 樹脂の特性 | |
|----------|----------|-----------|---------|
| | | 粘度(mPa·s) | 不揮発分(%) |
| BRL-211J | 鋳物用 レゾール | 100 — 150 | 65 — 69 |
| ARL-005 | 硬化剤 | 10 — 20 | 40 — 50 |

14

半導体封止材用

フリーフェノール、金属、ハロゲン元素等の不純物を徹底的に除去したノボラック型フェノール樹脂でエポキシと組み合わせ半導体・封止材の分野に使用されています。



| 品名 | 形状 | 用途・特長 | 樹脂の特性 | |
|---------|------|------------------------------------|---------------|---------|
| | | | 熔融粘度(Pa·s/°C) | 軟化点(°C) |
| BRG-555 | マーブル | 電子材料用 高純度ノボラック フリーフェノール含有量(%)≒0 | 0.3 — 0.5/125 | 66 — 72 |
| BRG-556 | | | 0.1 — 0.3/150 | 77 — 83 |
| BRG-557 | | | 0.2 — 0.4/150 | 82 — 88 |
| BRG-558 | | | 0.8 — 1.2/150 | 93 — 98 |
| CRG-951 | | | 0.2 — 0.8/150 | 93 — 99 |
| TAM-005 | 塊状 | | 0.3 — 0.5/150 | 80 — 88 |